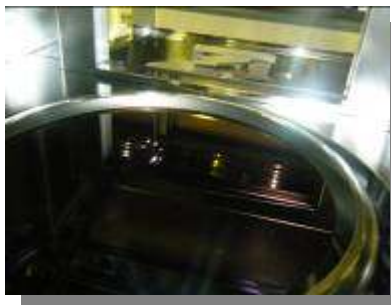
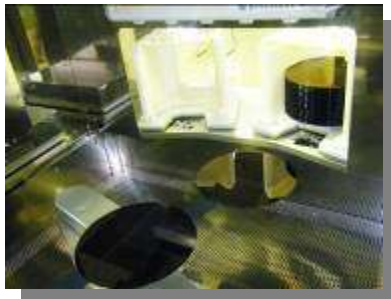


# スピコータ装置 MSC-200□□

セミコン・ジャパン 2009 出展

スピン式のコータ・デベロッパ・レジスト剥離などの単体機能をユニット化し、セミカスタム方式で多様なニーズに対応

- ☆ 基本スピコータの機能をコンパクトサイズ、廉価格でご提供
- ☆ 拡張ユニット・オプション設定の組合せにより、多目的な装置に対応
- ☆ MEMS ウェーハ対応



- 8インチ以下ウェーハのローダ、アンローダ、ロボット搬送、スピン機能を汎用ユニット化
- スピンユニット、拡張ユニットの組合せにより、多彩な装置へ展開可能
  - ・スピコータ ・コータデベロッパ ・スピン洗浄乾燥機 ・レジスト剥離装置 ・ウェーハソータなど
- 真空チャックホールドを標準として、MEMS ウェーハ、ベルヌーイ、エッジクランプ、ウェーハ反転など各種搬送に対応
- 両面同時処理、スピン高回転(5001rpm 以上)、特殊薬剤使用など、カスタムヘッド・チャンバに対応可能
  - ・チャンバ内適応薬剤: DIW、SPW、オゾン水、レジスト液、レジスト剥離液、その他
- ユニットの組合せにより、複合装置にも対応可能

対応液剤: フッ酸など各種酸系液、有機溶剤系、アルコール系、石油系など

※ 防爆対応もご相談ください。危険物のレベルに合わせて対応させていただきます。

## 基本ユニット仕様

項目	仕様
対象ワーク	Si ウェーハ、GaAs ウェーハ、SiC ウェーハ、ガラスマスクなど
ワークサイズ	Wφ=6・8” Wt=100~1000μm ※5”・200um 以下はご相談ください
カセット搭載数	標準: SEMI オープンカセット 25W×2カセット
チャンバ材質	標準: SUS304 ※目的に合わせて変更可能
スピン回転数	標準: Max5,000rpm ※5,001rpm 以上は、ご相談ください
ワークチャック方式	標準: 真空チャック オプション: エッジクランプ、ポールス、ベルヌーイなど
ワーク搬送方式	標準: 4軸ツインアーム RB 廉価オプション: 3軸シングルアーム RB
品種登録 / 切替	標準: 30 品種 / タッチパネル
チャンバ内吐出薬剤	標準: 上面1品種液 ※両面、多品種薬剤は、ご相談ください
回り込み防止機構	標準: なし オプション: バックリンス、ウォータウォールなど
クリーン対応	標準: FFU(HEPA) クラス 10 機器構成 オプション: ULPA など
外観寸法 / 重量	1625(W)×1425(D)×1750(H) / 約 800Kg (参考値)
ユーティリティ	AC200V±10 50/60Hz 3KVA Air 0.5MPa 70L/min

## 拡張ユニット仕様

拡張機能	機能説明
アライニング	非接触光学式アライニング オリフラ、ノッチ合わせ
ベーキング	ホットプレート 150°C±3 排気付き
デベロッパ	デベロッパ用スピンユニット
ID リーダ、画像検査	CCD カメラ
ワーク洗浄	レジスト剥離、不純物塗布前処理など

外観寸法図

